



LOTPASTE SC BLF02

Typ ISO 1.2.2.C

Die Lotpaste **SOLDER CHEMISTRY BLF 02** ist ein ausgereiftes High-Tech-Produkt, das für alle sog. bleifreie SMT-Anwendungen bestens geeignet ist. Ihrer Entwicklung liegen nicht nur die neusten Erkenntnisse in der Lötchemie, langjährige Erfahrung auf dem SMT-Gebiet, eine dauerhafte Zusammenarbeit mit den Benutzern von Dampfphasenlötanlagen inbegriffen, sondern auch die sorgfältige und strenge Beachtung der Richtlinien von ISO-, EN-, IPC- und MIL-Normen zugrunde.

Die **BLF 02** ist physikalisch gesehen eine gleichmäßige Mischung aus einem bleifreien Lotpulver, in allen erforderlichen Legierungen und Körnungen lieferbar, mit einem organischen Bindemittel auf Kunstharzbasis, das der Kl. RE L0 nach J-STD-005 oder RMA-Qualifizierung entspricht.

Außer der hervorragenden Konturenstabilität, keiner Lotkugel- oder Spritzerbildung, einer langzeitigen Verarbeitbarkeit und langen Standzeit, sowie hoher Temperaturstabilität, zeichnen diese Paste folgende Vorteile aus:

- * **BLF 02*** Eine feststoffarme Paste mit nur 4,6% Rückstand.
- * **BLF 02*** Die Rückstände entsprechen der RE-L0 Klassifizierung.
- * **BLF 02*** Enthält Korrosionsinhibitoren.
- * **BLF 02*** Eine hervorragende Druckqualität, stundenlang!
- * **BLF 02*** Hinterlässt keine teerartigen Rückstände in der Lötanlage.
- * **BLF 02*** Lötet problemlos auch auf leicht korrodierten Oberflächen.

PHYSIKALISCHE DATEN

| <u>Bevorzugte Legierungen</u> | <u>Schmelzpunkt</u> | Gemäß Internationalen Standard liefern wir diese Legierungen in den Klassen: | |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sn96,5/Ag3,5 | 221°C | Kl.3 | 25 – 45 µm |
| Sn95,5/Ag3,8/Cu0,7 | 217 – 219°C | Kl.4 | 20 – 35 µm |
| Sn96,5/Ag3/Cu0,5 | 217°C | Kl.5 | 10 – 25 µm |
| Sn99,3/Cu0,7 | 227°C | | |

VISKOSITÄT (Pa.S) ± 10% gemessen nach Brookfield RVT-DV II Viskosimeter mit 90% Metallgehalt:

| <u>Viskosität:</u> * | | Konturenstabilität – DIN 32513 | | Solderballing | Benetzung |
|----------------------|------------------|--------------------------------|------------|---------------|-----------|
| | | Sofort | 20min 80°C | nach IPC | nach IPC |
| 650 Pas | Pulverklasse III | Kl.1 = 0,2 | 0,2 | 1 | 1 |
| 800 Pas | Pulverklasse IV | Kl.2 = 0,2 | 0,3 | | |

OBERFLÄCHENWIDERSTAND (SIR) und elektrolytische Korrosionswirkung nach DIN 32513

| | | |
|------------|------------------------|------------------------|
| Messung am | 4.Tag | <u>21.Tag</u> |
| | 3,2 x 10 ¹² | 1,8 x 10 ¹² |

